

台灣半導體股份有限公司
112年股東常會議事錄

時間：中華民國 112 年 6 月 19 日(星期一)上午 9 時整。

地點：宜蘭縣宜蘭市梅洲二路 96 號(台灣半導體股份有限公司宜蘭廠)

出席：本公司已發行股份總數(扣除公司法第 179 條規定無表決權之股數後)為 263,485,486 股，親自出席及代理出席股東所代表之股數計 161,926,799 股(其中電子投票股數為 155,819,921 股)，佔已發行股份總數之 61.45%。出席股數已符合公司法及公司章程規定之出席股數。

列席：王秀亭董事長、鼎翰科技股份有限公司法人代表人王興磊董事、宏誠創業投資股份有限公司法人代表人：劉昌昱董事、詹乾隆獨立董事、林柏生獨立董事、范宏書獨立董事、馬述壯獨立董事等共計 7 人親自出席。
理律法律事務所：田仁杰律師。
安侯建業聯合會計師事務所：梅元貞會計師。

主席：王董事長秀亭



記錄：駱月桂



一、宣佈開會：出席股數已達公司法之規定，依法宣佈開會。

二、主席致詞：(略)。

三、報告事項

- (一)本公司 111 年度營業報告及 112 年度營業計劃報告，報請 公鑑。附營業報告書(附件一)。
- (二)審計委員會查核 111 年度決算表冊報告，報請 公鑑。附審計委員會審查報告書(附件二)。
- (三)報告本公司及子公司 111 年度背書保證、資金貸與他人、取得或處分資產辦理情形、從事衍生性金融商品交易情形，報請 公鑑。
- (四)111 年度董事酬勞金及員工酬勞分派情形報告。
- (五)董事及經理人之績效評估及薪資報酬之內容及數額與績效評估結果之關聯性及合理性報告。

四、承認事項

第一案

董事會提

案由：承認 111 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：

- (一)本公司 111 年度之營業報告書、個體財務報告及合併財務報告，業經董事會決議通過，並經審計委員會查核竣事。

(二)本案各項書表請參閱附件一及附件三。提請 承認。

決議：本議案投票表決結果如下：

投票時出席股東表決權數： 161,926,799 權

表決結果(含電子投票)	占投票時出席股東表決權數%
贊成權數： 152,733,203 權	94.32%
反對權數： 112,300 權	0.06%
無效票權數： 0 權	0.00%
棄權與未投票權數： 9,081,296 權	5.60%

本案經投票表決，照案承認。】

第二案

董事會提

案由：承認 111 年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：

(一)為健全資本結構，避免盈餘稀釋，擬全數配發現金股利。

(二)本公司 111 年度稅後純益為 NT\$ 1,562,886,413 元，提列法定盈餘公積 NT\$ 156,718,710 元，加計期初未分配盈餘 NT\$ 1,084,254,443 元，加確定福利計劃之再衡量數 4,300,684 元，本期可供分配盈餘為 NT\$ 2,494,722,830 元。擬分派股東紅利 NT\$1,053,941,944 元，全部以現金發放，俟股東常會通過後，另訂分配現金股利基準日及發放日；並依分配現金股利基準日股東名簿所載持股，每股配發 NT\$ 4.0 元，現金股利發放至元為止，未滿一元者不計，其畸零款合計數計入本公司之其他收入。嗣後如因本公司流通在外股數有增減變動，致股東配股(息)率因此發生變動者，擬提請股東會授權董事會全權處理之。

(三)盈餘分配表請參閱附件四。敬請 承認。

決議：本議案投票表決結果如下：

投票時出席股東表決權數： 161,926,799 權

表決結果(含電子投票)	占投票時出席股東表決權數%
贊成權數： 152,826,003 權	94.37%
反對權數： 115,497 權	0.07%
無效票權數： 0 權	0.00%
棄權與未投票權數： 8,985,299 權	5.54%

本案經投票表決，照案承認。】

五、討論事項

第一案

董事會提

案由：修訂本公司『公司章程』部份條文案，提請 討論。

說明：

(一)為公司未來發展需要，擬修訂本公司章程，其修訂前後對照表及其內容，

請各位股東自行參閱本議事手冊第 38 頁，並提請 112 年股東常會同意。

(二)提請 討論。

決 議：本議案投票表決結果如下：

投票時出席股東表決權數： 161,926,799 權

表決結果(含電子投票)	占投票時出席股東表決權數%
贊成權數： 130,305,786 權	80.47%
反對權數： 22,637,412 權	13.98%
無效票權數： 0 權	0.00%
棄權與未投票權數： 8,983,601 權	5.54%

本案經投票表決，照案通過。】

第二案

董事會提

案 由：修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部份條文案，提請 討論。

說 明：

(一)為公司營運需求，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，其修訂前後對照表及其內容說明，請各位股東自行參閱本議事手冊第 39 ~ 40 頁，並提請 112 年股東常會同意。

(三)提請 討論。

決 議：本議案投票表決結果如下：

投票時出席股東表決權數： 161,926,799 權

表決結果(含電子投票)	占投票時出席股東表決權數%
贊成權數： 129,391,973 權	79.90%
反對權數： 14,917,121 權	9.21%
無效票權數： 0 權	0.00%
棄權與未投票權數： 17,617,705 權	10.88%

本案經投票表決，照案通過。】

八、臨時動議：無。

九、散 會：上午 9 時 13 分。本次股東常會無股東提問。

以下為附件：

(附件一及附件三)

附件一：營業報告書

一、111 年度營業報告

1、營業計畫實施成果：

本公司及各子公司主要營業項目為整流器及條碼印表機之製造及買賣業務，111 年度本公司每股稅後盈餘為 6.28 元，茲將本公司 111 年度合併營收淨額、營業毛利、營業淨利、稅前淨利、本期淨利、本期綜合損益及

稅後每股盈餘等與 110 年度相較分析列示如下表：

單位：新台幣千元

項目名稱	年度經營情況		
	111年度	110年度	增(減)
營業收入淨額	15,687,134	13,177,417	19.05%
營業毛利	5,349,166	4,127,721	29.59%
營業淨利	2,790,521	1,908,907	46.18%
稅前淨利	3,013,930	1,947,632	54.75%
本期淨利	2,176,915	1,381,895	57.53%
本期綜合損益	2,478,073	1,269,814	95.15%
本期淨利歸屬母公司	1,562,877	882,805	77.04%
綜合損益歸屬母公司	1,738,755	809,542	114.78%
稅後每股盈餘	6.28元	3.55元	76.90%

2、預算執行情形：本公司111年度未公開財務預測，故無需揭露預算執行情形。

3、財務收支及獲利能力分析

單位：新台幣千元

項目名稱	年度收(支)情況		
	111年度	110年度	增(減)
利息收入	19,892	14,541	36.80%
利息費用	38,330	30,911	24.00%

項目		111年度	110年度
財務結構分析	負債佔資產比率(%)	41.12	42.28
	長期資金佔不動產、廠房及設備比率(%)	286.97	259.53
償債能力分析	流動比率(%)	206.86	206.04
	速動比率(%)	136.76	145.12
獲利能力分析	資產報酬率(%)	12.89	9.19
	權益報酬率(%)	21.82	16.19
	純益率(%)	13.88	10.49
	每股稅後盈餘(元)	6.28	3.55

4、研究發展狀況：

(A)整流器

本公司為提升整體競爭力及毛利率，每年均投入大量人力與預算，蒐集市場資訊，分析市場需求，訂定新產品開發方向與策略。由於現今市場

主流產品多朝向輕薄短小發展，為拓展新市場，本公司產品亦積極朝向小型，節能與整體方案化發展，已在個人手攜式產品、持續專注於汽車電子、工控產業與白色家電市場開發並提升市場滲透率產業。

近年憑藉著自行開發晶片技術以及自動化封裝優勢，持續在蕭特基整流器、MOSFET、ESD保護元件、LED驅動IC，車用低壓差低耗電穩壓IC等產品進行研發。

晶片技術研發新一代的溝槽式蕭特基整流器(Trench schottky rectifier)，超接面金氧半場效電晶體(Super Junction MOSFET)，以及屏蔽技術SGT(SplitGate Technology)MOSFET有效降低導通損耗與開關損失，滿足環保以及節能低功耗的市場趨勢與需求。這些新技術將全系列開發以利推廣於用汽車電子主被動安全應用、工業、通訊、能源產業。

全自動化固晶技術及全自動超高速封測印字技術已全面導入，有利於提升產品信賴性與大幅增加產出與降低生產成本以協助業務擴大市場佔有率及提升獲利能力。封裝技術研發更高電流密度的貼片式功率元件，技術凌駕歐美日系大廠。

ESD保護元件的開發持續專注於多通道、超低接面容值與微型封裝。對應市場各類高頻傳輸接口的應用如USB3.1、USB3.0、USB2.0、HDMI2.0端口靜電保護。

本公司已投入量產全系列LED 照明產品線，可應用各類方案包含隔離、非隔離及調光系統。調光系列涵蓋現有調光方式如線性調光、PWM調光等，以及各類內置高階金氧場效電晶體方案，已臻至成熟，並已獲得國際大廠採用，也持續穩定成長。面對中國大陸低價競爭市場，本公司亦積極尋求更高品質與毛利的產品並與客戶合作開發客製化產品，尤其聚焦於車用產品更是近年主力研發重點項目，包含各類的車用LED驅動IC，可涵蓋於車用照明各種電壓與應用，如頭燈，尾燈，霧燈，日行燈等。而各類低功耗高輸出電流的車用低壓差低耗電穩壓器IC也陸續開發中，可涵蓋於供應給車用MCU 3.3V及5V的穩壓源，目前已有部分 自主研發完成，且已投入更多人力及設備成本在車用法規的驗證，目前正陸續通過AEC-Q100車用法規的驗證，希望能以高品質與服務獲得車用客戶的認可。

(B)條碼印表機

隨著全球市場對自動辨識的應用增加，本公司111年度研發支出共投入229,823仟元，占全年度營業收入達3%，並持續投入網路應用與網路安全以及雲端的軟硬體應用開發，以擴大公司市場的覆蓋範圍。此外，新一代產品研發及新領域的應用開發，係著重自動資料收集、產品可移動性、RFID應用，在線條碼檢測，以及無底紙環保標籤應用等。本集團亦將資金挹注於標籤紙設備資本支出，以提高市場競爭力，持續開創公司營收成長空間。

二、112 年度營業計劃

1、經營方針：

(A)整流器

- (1)持續佈建全球行銷通路，以擴增全球市場佔有率。
- (2)強化海內外專業化之行銷團隊，以技術與全方位服務客戶並提升公司品牌形象。
- (3)持續擴充研發團隊，積極創造並保持領先技術與快速開發次世代產品。
- (4)持續開發並導入最先進生產設備以大幅增加產出與降低成本提升獲利能力。
- (5)積極開發新型封裝技術與高電流密度極薄貼片式封裝迎合市場需求。
- (6)爭取國際知名廠商合作，強化體質。
- (7)持續開發車規小訊號產品並針對車用電子，全方位產品線服務。
- (8)積極推動車規類比IC、金氧場效電晶體與LED驅動IC及高壓高流模組產品，以整合方案銷售提升產品價值與獲利並贏得客戶信賴及依賴。
- (9)持續晶圓上游產品開發生產以整合產業上下游供應，確保關鍵原物料穩定供應與絕對的成本優勢。
- (10)與世界大廠合作共同開發新產品，以供應鏈之寡占性創造高利潤。

(B)條碼印表機

積極推出新產品以鞏固現有領域，持續開發客戶所需之完整軟硬體解決方案，拓展低中高階全產品線之行銷通路，深化公司自有品牌於全球各區域經營，增加客戶於自動辨識系統的智慧服務運用，以提供客戶更完整的應用服務網絡，為客戶創造多元價值；同時著重規劃上下游策略投資，為公司開發新的成長動能。

2、重要產銷政策：

(A)整流器

本公司所屬產業為半導體業，目前本公司之產銷政策係採計劃性與接單式生產併行策略，對此依據市場整體產業發展、市場供需、公司既定產能及庫存水位擬定年度計劃產銷政策，並視實際接單狀況隨時予以調整，據以管控最佳水平庫存量。

(B)條碼印表機

未來產銷政策方面的進行重點如下：

- (1)確保重要供應商的供貨來源及品質穩定，並維持適當之庫存金額與週轉率。
- (2)強化各區域經銷業務之教育訓練以提昇銷售。
- (3)持續開發新興市場與成熟市場。

3、營業目標：

(A)整流器

本公司主要產品為整流二極體及類比IC，考量產業競爭及市場景氣狀況，預計112年度之預期銷售數量如下：

產 品 別	112 年度預期銷售數量	111 年度實際銷售數量
整流二極體	5,596,986(kpcs)	4,443,018(kpcs)
小訊號產品	1,797,234(kpcs)	1,867,206(kpcs)
金氧半場效電晶體	305,924 (kpcs)	287,774(kpcs)
類比 IC	136,912(kpcs)	130,243(kpcs)

技術行銷(Technical Marketing)-針對不同產業別，以整體解決方案(Total solution)全面推廣。並於深耕多年的汽車電子市場，因油電混合與純電動車日益普遍，對於功率元件市場需求激增。高功率AC-DC轉換器、低損耗MOS(場效電晶體)、低損耗穩壓器、突波吸收器(TVS)、靜電保護、快速恢復二極體、電晶體持續出貨歐美日廠商，另也積極開發高速成長的大陸及印度車電系統廠。汽車照明也因法規調整，須裝置日間照明，亦因節能與新照明產品趨勢，LED照明應用於汽車上快速崛起，量能均呈倍數成長。本公司亦積極於車用照明市場中提供整體解決方案並加速導入歐美日車電系統廠。

汽機車充電系統除既有產品高功率橋式與高功率整流器，新產品高功率MOS以汽車電子認證廠家身分切入，大幅縮短認證時間。

照明產業LED，新產品LED module、LED driver，包含定電流整流功能簡化設計，以全方位解決方案包含貼片式橋式、蕭特基、MOSFET、小訊號產品推廣需求量的球泡燈與燈條，導入美系歐系照明領導品牌。除小型照明，新產品也開發AC-DC LED應用導入美、日系廠商。

由外商寡佔的工業應用市場特別是再生性能源產業(太陽能系統與電源轉換器)，具有低取代性與高毛利的市場區隔特性，本土與大陸廠商難以導入。本公司累積汽車電子產業經營多年的高品質管控與實績與全球化的當地設計服務導入速度較快。除既有產品外，新產品高功率快速恢復整流器、低損耗高結溫Trench蕭特基、低功耗高壓MOSFET全包式推廣中。

近年來，中國大陸汽車電子、檢測儀器儀表、工業控制和家用電器市場蘊含的相當大商機吸引越來越多的國外廠商進入。本公司將開發不同規格的霍爾感應IC以及磁性傳感器，主要泛用於汽車、工業、家用電器和消費市場。在這些市場中，這些 IC 用於各種位置和角度測量應用。以汽車電子動力轉向系統為例，線性和角度位置霍爾效應感測器 IC 可測量轉向盤的角度、轉矩和轉速。在工業工廠自動化市場中，這些 IC 用於檢測液壓控制閥和操縱杆的接近和角度，在家用電器和消費市場中，則用於控制和打開/關閉檢測系統。

鞏固既有產品線推廣消費性電子產業，如TV、PC/Tablet、STB、Home appliance、Gaming、GPS，持續放大出貨量，如橋式整流器、MOS、蕭特基、基納二極體、開關二極體、各式穩壓器、快速恢復整流器等。

電視結合網路功能，影音功能，高頻率與多連接埠的裝置。為保護IC更需要靜電保護元件及濾波器件；新產品靜電保護全系列開發包含多

組輸出Array，另也開發結合EMI Filter。在ECO-Friendly的需求下，終端產品皆追求高效率化低損耗，新產品開發低阻抗MOS、低損耗穩壓器、低損耗橋式、超低電容靜電保護元器件等。

Machine to Machine, IoT的物聯網興起以及5G通訊智慧城市的革命性應用的需求，超低損耗低壓金氧半場效電晶體與低壓溝槽式蕭特基，高功率低壓小貼片TVS等陸續推廣中。

(B)條碼印表機

本公司主要營收來源為自動辨識列印機整機銷售與服務、標籤紙耗材銷售等，預計112年度之預期銷售數量如下：

單位：千台

產品別	112年度預期銷售數量	111年度實際銷售數量
自動辨識列印機	800	700

在此預計基礎下，未來產銷政策方面的進行重點如下：

1. 確保重要供應商的供貨來源及品質穩定，並維持適當之庫存金額與週轉率。
2. 持續擴大全球營運規模及強化公司營運基本面之核心競爭力。
3. 提供全方位優質服務，建立永續經營實力。

三、未來公司發展策略、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

1、未來公司發展策略

(A)整流器：持續不斷的技術創新、加速研究發展、提高產品價值、上下游完整佈局與大陸地區的投資先機以強化整合效益。

(B)條碼印表機：除持續以自有品牌行銷擴展市場佔有率及提升競爭優勢，優化售後管理服務，提升客戶服務品質，關注經濟發展趨勢所產生的應用，擴展各類智慧應用軟體，提供客戶更多價值，創造多贏成長契機。

2、受到外部競爭環境之影響。

(A)整流器

大陸半導體廠家因當地政府補貼政策以低價競爭對中低端消費性應用市場有一定的影響。本公司仍致力於更高規格的產品開發，從消費性電子、汽車電子、工業控制到醫療與通訊設備更大廣度的開發滲透，期以達到低中高應用市場平衡發展並佔據更多跨入門檻較高的領域保持與後起競爭對手較大的差距並提升獲利能力。目前本公司新技術研發及現有高端產品已與世界一級大廠媲美甚或超越，期開發更多創新及革命性產品以超越世界級競爭對手並對地球環保節能減碳做出卓越的貢獻。

(B)條碼印表機

隨著自動辨識需求應用更加生活化以及普及化，對自動辨識列印的需求愈趨活絡，面對外部的競爭環境，本公司持續耕耘研發新創技術，

深化整合資源及跨域發展的核心能力，拓展市場合作與連結，積極面對外部挑戰並以營收及獲利穩定成長為公司目標。

3、法規環境之影響

(A) 整流器

因應歐盟RoHS規範，目前本公司全系列提供無鹵產品獲歐洲、美系、日系、韓系消費性大廠青睞。EISA2007 (六級能效)自2016年開始執行，對於各項電器產品的待機耗電量與電力轉換效率要求更高。對功率元件，整流器與金氧半場效電晶體的電性要求須更低損耗更小包裝。影響最鉅的白色家電因馬達與壓縮機耗電量大因應法律需求必須切換變頻電壓源起動馬達對功率元件電性要求更高壓更快速軟切換的能力。直流變頻的白色家電因功率元件需克服磁干擾因素，台半優異的晶片研發能力使低成本訴求的廠商難望其項背再生性能源的政策持續推廣，對於太陽能與再生性能源的需求除北美、日本、歐洲等高度開發區需求外，新興市場也應聲而起，新產品低耗損高結溫蕭特基可結合應用太陽能模組與電源轉換器。

電動車電池技術的突破，充電規範由AC轉為DC 600V直接充電，汽車的電力系統也將由12V 24V系統轉換為48V系統，對於電力系統的轉換，原本供應商的design pool已需要更換新的規格。是台半新產品高壓快速恢復二極體、超低功耗整流器以及溝槽式蕭特基很好的切入設計點。

(B) 條碼印表機

最近年度國內外重要政策與法律之變動對公司營運並無重大影響。

4、總體經營環境之影響

(A) 整流器

Global Service-客戶管理系統與區域產業發展全球無國界的分工化，本公司以客戶管理來因應變化快速的電子產業。全球大廠皆由原廠當地設計，各地交貨生產；對於代工模式與IPO的營業方式透過"Account management"做到滴水不漏的接單服務。

區域產業發展有助平衡產品結構與體質強化。北美洲市場著重汽車、工業、電信、照明。日本市場產業著重汽車、工業。歐洲市場著重汽車電子、工業、再生性能源與照明。大陸市場著重消費性電子、汽車、工業以及新興市場如印度、南亞、俄羅斯、南美洲，由於中產階級急增，內需市場擴大；基礎電信電纜照明建設與Home appliance, Telecom等都是目前導入的產業。

本公司全球化佈局策略對於現今無國界的代工模式與分散區域經濟體強弱之風險在瞬息萬變的景氣動態中更體現其效率與遠見。

(B) 條碼印表機

對於法規環境的變化亦均予以遵循。

展望未來，本公司及各子公司隨著整流器及條碼印表機市場的穩定成長及應用範圍日益擴展，加上垂直布局趨於完整，我們將秉持創新、專業與敬業的經營理念，並持續強化團隊的研發及銷售能力，提昇業績與獲利，讓股東、客戶及員工共享豐碩的營運成果。

董事長：王秀亭



經理人：王秀亭



會計主管：鄭懿誠



附件三：財務報表



安侯建業聯合會計師事務所

KPMG

台北市11049信義路5段7號68樓(台北101大樓)
68F., TAIPEI 101 TOWER, No.7, Sec. 5,
Xinyi Road, Taipei City 11049, Taiwan (R.O.C.)

Telephone 電話 + 886 (2) 8101 6666

Fax 傳真 + 886 (2) 8101 6667

Internet 網址 kpmg.com/tw

會計師查核報告

台灣半導體股份有限公司董事會 公鑒：

查核意見

台灣半導體股份有限公司民國一一一年及一一〇年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一一一年及一一〇年一月一日至十二月三十一日之綜合損益表、權益變動表及現金流量表，以及個體財務報告附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告（請參閱其他事項段），上開個體財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達台灣半導體股份有限公司民國一一一年及一一〇年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一一一年及一一〇年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報告之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與台灣半導體股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

其他事項

列入台灣半導體股份有限公司採用權益法之投資中，有關鼎翰科技股份有限公司之財務報告未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開個體財務報告所表示之意見中，有關鼎翰科技股份有限公司財務報告所認列之金額，係依據其他會計師之查核報告。民國

一一一年及一一〇年十二月三十一日對鼎翰科技股份有限公司採用權益法之投資金額分別占資產總額之8.68%及8.26%，民國一一一年及一一〇年一月一日至十二月三十一日對其採用權益法認列之子公司利益份額分別占稅前淨利之17.16%及26.34%。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對台灣半導體股份有限公司民國一一一年度個體財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報告整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

一、應收款項評價

有關應收款項評價之會計政策請詳個體財務報告附註四(六)金融工具；應收款項之減損評估之會計估計及假設不確定性，請詳個體財務報告附註五；應收帳款評價之說明，請詳個體財務報告附註六(三)應收票據及帳款。

關鍵查核事項之說明：

台灣半導體股份有限公司擁有廣大客戶群，而因應收款項收款天數長短不一，故應收款項之預期信用損失係管理階層之經驗判斷，因此，應收款項評價為本會計師執行查核重要評估事項之一。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括檢視未及時收款原因之合理性及期後收款情形；評估管理當局對應收款項預期信用損失之假設、公司以往年度實際收款情形等資料，以評估帳列應收款項預期信用損失之合理性；另外，本會計師並評估個體財務報告有關事項已允當揭露。

二、採用權益法之投資減損評估

有關採用權益法之投資之會計政策請詳個體財務報告附註四(八)投資子公司；採用權益法之投資之說明，請詳個體財務報告附註六(五)採用權益法之投資。

關鍵查核事項之說明：

台灣半導體股份有限公司採用權益法之投資中，於企業合併取得業務及控制權時，於合併財務報告認列商譽，該等金額對財務報告係屬重大，此外，衡量商譽是否減損，有賴對現金產生單位未來現金流量之估計以決定可回收金額，未來現金流量之估計涉及產業狀況及未來營運成果等之預估，該等預估情況一旦改變，將影響可回收金額而產生減損。因該等採用權益法之投資係台灣半導體股份有限公司之重要轉投資且該帳面金額對個體財務報告係屬重大，因此，本會計師認為台灣半導體股份有限公司對該等採用權益法之投資所作之減損評估，為本年度查核重要事項評估之一。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括取得台灣半導體股份有限公司管理階層委任之評價專家所出具之商譽價值減損測試評估報告，詢問並評估其專業能力及獨立性；本會計師另委託內部專家執行攸關程序以評估採用之評價模型及加權平均資金成本等重要假設之合理性；考量公司過去營運狀況、所屬產業情況及未來展望等，綜合評估上述商譽減損評估之合理性。

針對採用其他會計師查核報告事項，本會計師與其他會計師進行溝通，包括對其他會計師發出查核指示函，並取得經其他會計師對鼎翰科技簽證之查核報告。

其他會計師針對商譽之查核程序則包括取得鼎翰科技管理階層委任之評價專家所出具之商譽價值減損測試評估報告，瞭解並評估其評價模型所計算可回收金額之合理性；並對評價模型所使用之假設包括銷售成長率、利潤率、加權平均資金成本（包括無風險報酬利率、波動性及風險貼水報酬）等，考量公司過去營運狀況、所屬產業情況及未來展望等，綜合評估上述商譽減損評估之合理性。

本會計師亦比較採用權益法之投資帳面金額及鼎翰科技財務報告中所揭露之其淨資產餘額差異（依台灣半導體股份有限公司持有之所有權份額）及觀察鼎翰科技於證券市場之價格。另外，本會計師並評估個體財務報告附註之有關資訊已允當揭露。

管理階層與治理單位對個體財務報告之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個體財務報告，且維持與個體財務報告編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報告時，管理階層之責任包括評估台灣半導體股份有限公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算台灣半導體股份有限公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

台灣半導體股份有限公司之治理單位（含審計委員會）負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核個體財務報告之責任

本會計師查核個體財務報告之目的，係對個體財務報告整體是否存在導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報告存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響個體財務報告使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估個體財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。

2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對台灣半導體股份有限公司內部控制之有效性表示意見。

3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。

4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使台灣半導體股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒個體財務報告使用者注意個體財務報告之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致台灣半導體股份有限公司不再具有繼續經營之能力。

5. 評估個體財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及個體財務報告是否允當表達相關交易及事件。



6. 對於採用權益法之被投資公司之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報告表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成台灣半導體股份有限公司之查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現(包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項(包括相關防護措施)。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對台灣半導體股份有限公司民國一一一年度個體財務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：
梅元貞 
許育峰 

證券主管機關：金管證六字第0940100754號

核准簽證文號：台財證六字第0930105495號

民國 一 一 二 年 三 月 十 五 日

台灣半導體股份有限公司

資產負債表

民國一十一年及一十〇年十二月三十一日

單位：新台幣千元

資 產	111.12.31		110.12.31			負債及權益	111.12.31		110.12.31	
	金 額	%	金 額	%			金 額	%	金 額	%
流動資產：						流動負債：				
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 1,139,543	10	567,039	6		2100 短期借款(附註六(九))	\$ 590,000	5	370,720	4
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動(附註六(二))	-	-	152,006	1		2120 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動(附註六(二))	408	-	120	-
1150 應收票據淨額(附註六(三))	52	-	531	-	2150 應付票據	-	-	1,607	-	
1170 應收帳款淨額(附註六(三))	618,016	5	718,390	7	2170 應付帳款	482,502	4	314,254	3	
1180 應收帳款－關係人淨額(附註七)	670,796	6	558,975	6	2181 應付帳款－關係人(附註七)	338,627	3	664,236	7	
1200 其他應收款(附註七)	38,005	-	24,318	-	2220 其他應付款項－關係人(附註七)	38,555	-	55,327	1	
130X 存貨(附註六(四))	1,193,998	10	760,114	8	2230 本期所得稅負債	221,499	2	123,065	1	
1479 其他流動資產	109,435	1	69,339	1	2320 一年內到期長期借款(附註六(十))	259,349	2	-	-	
	<u>3,769,845</u>	<u>32</u>	<u>2,850,712</u>	<u>29</u>	2399 其他流動負債	418,550	4	294,810	2	
						<u>2,349,490</u>	<u>20</u>	<u>1,824,139</u>	<u>18</u>	
非流動資產：						非流動負債：				
1517 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動(附註六(二))	4,157	-	-	-	2541 長期借款(附註六(十))	527,391	5	649,310	7	
1551 採用權益法之投資(附註六(五))	5,113,463	45	4,414,662	44	2570 遞延所得稅負債(附註六(十二))	441,616	4	382,147	4	
1600 不動產、廠房及設備(附註六(六))	2,168,878	19	2,379,502	24	2640 淨確定福利負債(附註六(十一))	20,046	-	23,057	-	
1822 無形資產(附註六(七))	64,459	1	91,453	1		<u>989,053</u>	<u>9</u>	<u>1,054,514</u>	<u>11</u>	
1840 遞延所得稅資產(附註六(十二))	70,596	1	39,221	-		<u>3,338,543</u>	<u>29</u>	<u>2,878,653</u>	<u>29</u>	
1980 其他金融資產－非流動(附註六(二))	67,718	1	55,415	1						
1990 其他非流動資產(附註六(八))	141,359	1	74,343	1						
	<u>7,630,630</u>	<u>68</u>	<u>7,054,596</u>	<u>71</u>						
						負債總計				
						權 益：(附註六(十三))				
					3110 普通股股本		2,634,854	23	2,650,854	27
					3200 資本公積		2,137,088	19	2,166,799	22
					3300 保留盈餘		4,155,591	36	3,247,117	32
					3400 其他權益		(359,558)	(3)	(531,125)	(5)
					3500 庫藏股票		(506,043)	(4)	(506,990)	(5)
							<u>8,061,932</u>	<u>71</u>	<u>7,026,655</u>	<u>71</u>
							<u>\$ 11,400,475</u>	<u>100</u>	<u>9,905,308</u>	<u>100</u>
						負債及權益總計				

董事長：王秀亭



經理人：王秀亭



(請詳閱後附個體財務報告附註)

會計主管：鄭懿誠





民國一十一年及一〇年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	111年度		110年度	
	金額	%	金額	%
4110 銷貨收入(附註六(十四)及七)	\$ 5,755,056	101	4,851,282	101
4190 減: 銷貨退回及折讓	55,901	1	47,805	1
營業收入淨額	5,699,155	100	4,803,477	100
5000 營業成本(附註六(四)及七)	4,058,148	71	3,896,023	81
營業毛利	1,641,007	29	907,454	19
5910 減: 未實現銷貨(損)益	53,444	1	3,081	-
	1,587,563	28	904,373	19
6000 營業費用(附註七):				
6100 推銷費用	438,244	8	388,376	8
6200 管理費用	297,659	5	202,130	4
6300 研究發展費用	81,604	1	56,976	1
	817,507	14	647,482	13
營業淨利	770,056	14	256,891	6
營業外收益及費損(附註六(十五)及七):				
7100 利息收入	3,635	-	1,421	-
7010 其他收入	28,629	1	7,485	-
7020 其他利益及損失	164,096	3	12,203	-
7050 財務成本	(11,349)	-	(6,775)	-
7070 採用權益法認列子公司利益之份額(附註六(五))	874,492	15	734,675	15
	1,059,503	19	749,009	15
稅前淨利	1,829,559	33	1,005,900	21
7950 減: 所得稅費用(附註六(十二))	266,672	5	123,095	3
本期淨利	1,562,887	28	882,805	18
8300 其他綜合損益:				
8310 不重分類至損益之項目				
8311 確定福利計畫之再衡量數(附註六(十一))	2,549	-	(1,247)	-
8330 採用權益法認列之子公司之其他綜合損益之份額—不重分類至損益之項目	1,752	-	(191)	-
	4,301	-	(1,438)	-
8360 後續可能重分類至損益之項目				
8361 國外營運機構財務報表換算之兌換差額	171,567	3	(71,825)	(1)
8300 本期其他綜合損益(稅後淨額)	175,868	3	(73,263)	(1)
本期綜合損益總額	\$ 1,738,755	31	809,542	17
基本每股盈餘(元)(附註六(十七))	\$ 6.28		3.55	
稀釋每股盈餘(元)(附註六(十七))	\$ 3.52		2.17	

董事長: 王秀亭



(請詳閱後附個體財務報告附註)

經理人: 王秀亭



會計主管: 鄭懿誠



台灣半導體股份有限公司



權益變動表

民國一一年及一〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	股本			保留盈餘			合計	其他權益項目	庫藏股票	權益總額
	普通股 股本	預收股本	資本公積	法定盈 餘公積	特別盈 餘公積	未分配 盈餘		國外營運 機構財務報表 換算之兌換 差額		
民國一〇年一月一日餘額	\$ 2,494,539	22,196	1,516,265	830,920	445,618	1,484,440	2,760,978	(459,300)	(506,990)	5,827,688
本期淨利	-	-	-	-	-	882,805	882,805	-	-	882,805
本期其他綜合損益	=	=	=	=	=	(1,438)	(1,438)	(71,825)	=	(73,263)
本期綜合損益總額	=	=	=	=	=	881,367	881,367	(71,825)	=	809,542
可轉換公司債轉換	156,315	(22,196)	604,864	-	-	-	-	-	-	738,983
盈餘指撥及分配：										
提列法定盈餘公積	-	-	-	53,967	-	(53,967)	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	-	13,682	(13,682)	-	-	-	-
現金股利	-	-	-	-	-	(395,228)	(395,228)	-	-	(395,228)
發放予子公司股利調整資本公積	-	-	20,400	-	-	-	-	-	-	20,400
採用權益法認列之關聯企業之變動數	=	=	25,270	=	=	=	=	=	=	25,270
民國一〇年十二月三十一日餘額	2,650,854	-	2,166,799	884,887	459,300	1,902,930	3,247,117	(531,125)	(506,990)	7,026,655
本期淨利	-	-	-	-	-	1,562,887	1,562,887	-	-	1,562,887
本期其他綜合損益	=	=	=	=	=	4,301	4,301	171,567	=	175,868
本期綜合損益總額	=	=	=	=	=	1,567,188	1,567,188	171,567	=	1,738,755
庫藏股註銷	(16,000)	-	(69,482)	-	-	-	-	-	85,482	-
子公司購入母公司之股票視為庫藏股票	-	-	-	-	-	-	-	-	(84,535)	(84,535)
盈餘指撥及分配：										
提列法定盈餘公積	-	-	-	88,137	-	(88,137)	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	-	71,825	(71,825)	-	-	-	-
現金股利	-	-	-	-	-	(658,714)	(658,714)	-	-	(658,714)
發放予子公司股利調整資本公積	-	-	37,000	-	-	-	-	-	-	37,000
採用權益法認列之關聯企業之變動數	=	=	2,771	=	=	=	=	=	=	2,771
民國一一年十二月三十一日餘額	\$ 2,634,854	=	2,137,088	973,024	531,125	2,651,442	4,155,591	(359,558)	(506,043)	8,061,932

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：王秀亭



經理人：王秀亭



會計主管：鄭懿誠



台灣半導體股份有限公司

現金流量表

民國一〇一一年及一〇一〇年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	111年度	110年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 1,829,559	1,005,900
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	319,548	319,368
攤銷費用	48,443	37,443
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失	1,701	1,966
利息費用	9,810	5,341
利息收入	(3,635)	(1,421)
採用權益法認列之子公司利益之份額	(874,492)	(734,675)
處分及報廢不動產、廠房及設備利益	(2,792)	(819)
其他	53,444	3,081
收益費損項目合計	(447,973)	(369,716)
與營業活動相關之資產/負債變動數：		
透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少	150,593	(149,691)
應收票據(增加)減少	479	(498)
應收帳款(增加)減少	100,374	(251,660)
應收帳款—關係人增加	(111,821)	(169,242)
其他應收款增加	(13,231)	(13,695)
存貨增加	(433,884)	(151,930)
其他流動資產(增加)減少	(40,096)	7,708
應付票據減少	(1,607)	(45)
應付帳款增加	168,248	109,498
應付帳款—關係人增加(減少)	(325,609)	131,409
其他應付款增加	637	296
其他應付款—關係人增加(減少)	(16,772)	27,224
其他流動負債增加	123,740	99,561
淨確定福利負債減少	(462)	(577)
調整項目合計	(847,384)	(731,358)
營運產生之現金流入	982,175	274,542
收取之利息	3,179	1,439
收取之股利	250,906	356,977
支付之利息	(10,913)	(5,761)
支付之所得稅	(140,144)	(74,360)
營業活動之淨現金流入	1,085,203	552,837
投資活動之現金流量：		
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(4,157)	-
取得不動產、廠房及設備	(52,494)	(46,996)
處分不動產、廠房及設備	3,475	713
取得無形資產	(21,449)	(27,475)
其他非流動資產(增加)減少	(2,617)	13,199
預付設備款增加	(133,453)	(53,363)
投資活動之淨現金流出	(210,695)	(113,922)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加(減少)	219,280	(236,240)
償還可轉換公司債	-	(41,900)
舉借長期借款	139,320	379,760
償還長期借款	(1,890)	-
發放現金股利	(658,714)	(395,228)
籌資活動之淨現金流出	(302,004)	(293,608)
本期現金及約當現金增加數	572,504	145,307
期初現金及約當現金餘額	567,039	421,732

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：王秀亭



經理人：王秀亭



會計主管：鄭懿誠



聲 明 書

本公司民國一一一年度(自一一一年一月一日至一一一年十二月三十一日止)依「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報表之公司與依金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則第10號應納入編製母子公司合併財務報告之公司均相同，且關係企業合併財務報表所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報告中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報表。

特此聲明

公司名稱：台灣半導體股份有限公司

董 事 長：王秀亭



日 期：民國一一二年三月十五日



安侯建業聯合會計師事務所

KPMG

台北市11049信義路5段7號68樓(台北101大樓)
68F., TAIPEI 101 TOWER, No.7, Sec. 5,
Xinyi Road, Taipei City 11049, Taiwan (R.O.C.)

Telephone 電話 + 886 (2) 8101 6666

Fax 傳真 + 886 (2) 8101 6667

Internet 網址 kpmg.com/tw

會計師查核報告

台灣半導體股份有限公司董事會 公鑒：

查核意見

台灣半導體股份有限公司及其子公司(台半集團)民國一一年及一一〇年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一一年及一一〇年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，以及合併財務報告附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告(請參閱其他事項段)，上開合併財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達台半集團民國一一年及一一〇年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一一年及一一〇年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效及合併現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報告之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與台灣半導體股份有限公司及其子公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

其他事項

列入台半集團合併財務報告之子公司中，有關鼎翰科技股份有限公司之財務報告未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開合併財務報告所表示之意見中，有關鼎翰科技股份有限公司財務報告所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。鼎翰科技股份有限公司民國一一年及一一〇年十二月三十一日之資產總額分別占合併資產總額之39.48%及41.27%，民國一一年及一一〇年一月一日至十二月三十一日之營業收入淨額分別占合併營業收入淨額之50.79%及51.97%。

台灣半導體股份有限公司已編製民國一一年及一一〇年度之個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見加其他事項段之查核報告在案，備供參考。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對台半集團民國一一一年度合併財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報告整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

一、應收款項評價

有關應收款項評價之會計政策請詳合併財務報告附註四(七)金融工具；應收款項之減損評估之會計估計及假設不確定性，請詳合併財務報告附註五；應收帳款評價之說明，請詳合併財務報告附註六(三)應收票據及帳款。

關鍵查核事項之說明：

台半集團擁有廣大客戶群，而因應收款項收款天數長短不一，故應收款項之預期信用損失存有管理階層之經驗判斷，因此，應收款項評價為本會計師執行台半集團查核重要評估事項之一。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括檢視未收款原因之合理性及期後收款情形；評估管理當局對應收款項預期信用損失之假設、公司以往年度實際收款情形等資料，以評估帳列應收款項預期信用損失之合理性；另外，本會計師並評估合併財務報告有關事項已允當揭露。

二、商譽之減損評估

有關商譽減損之會計政策請詳合併財務報告附註四(十二)非金融資產減損；合併財務報告商譽減損之說明，請詳合併財務報告附註六(九)商譽。

關鍵查核事項之說明：

台半集團於取得業務及控制權時，於合併財務報告認列商譽，該等金額對合併財務報告係屬重大。此外，衡量商譽是否減損，有賴對現金產生單位未來現金流量之估計以決定可回收金額，未來現金流量之估計涉及產業狀況及未來營運成果等之預估，該等預估情況一旦改變，將影響可回收金額而產生減損。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括取得管理階層委任之評價專家所出具之商譽價值減損測試評估報告，詢問並評估其專業能力及獨立性；本會計師另委託內部專家執行攸關程序以評估採用之評價模型及加權平均資金成本等重要假設之合理性；考量台半集團營運狀況、所屬產業情況及未來展望等，綜合評估上述商譽減損評估之合理性。

針對採用其他會計師查核報告事項，本會計師與其他會計師進行之溝通，包括對其他會計師發出查核指示函，並取得經其他會計師對鼎翰科技股份有限公司(鼎翰科技)執行查核後之查核報告。其他會計師查核程序則包括取得鼎翰科技管理階層委任之評價專家所出具之商譽價值減損測試評估報告，瞭解並評估其評價模型所計算可回收金額之合理性；並對評價模型所使用之假設包括銷售成長率、利潤率、加權平均資金成本(包括無風險報酬利率、波動性及風險貼水報酬)等，考量公司營運狀況、所屬產業情況及未來展望等，綜合評估上述商譽減損評估報告之合理性。另外，本會計師評估其他會計師依據相關審計準則所設計查核程序之適當性，並評估合併財務報告附註之有關資訊已允當揭露。

管理階層與治理單位對合併財務報告之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報告，且維持與合併財務報告編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報告時，管理階層之責任包括評估台半集團繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算台半集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

台半集團之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核合併財務報告之責任

本會計師查核合併財務報告之目的，係對合併財務報告整體是否存在導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報告存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報告使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估合併財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。

2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對台半集團內部控制之有效性表示意見。

3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。

4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使台半集團繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報告使用者注意合併財務報告之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致台半集團不再具有繼續經營之能力。

5. 評估合併財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及合併財務報告是否允當表達相關交易及事件。

6. 對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報告表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團之查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現(包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項(包括相關防護措施)。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對台半集團民國一一一年度合併財務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

安侯建業聯合會計師事務所

招元貞



會計師：

許育峰



證券主管機關：金管證六字第0940100754號

核准簽證文號：台財證六字第0930105495號

民國 一 一 二 年 三 月 十 五 日

台灣半導體股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國一一年及一〇年十二月三十一日

單位：新台幣千元

資 產	111.12.31		110.12.31		負債及權益	111.12.31		110.12.31	
	金 額	%	金 額	%		金 額	%	金 額	%
流動資產：					流動負債：				
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 3,595,681	20	2,701,648	17	2100 短期借款(附註六(十一))	\$ 1,466,515	8	921,426	6
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動(附註六(二))	1,798	-	155,067	1	2120 透過損益按公允價值衡量之金融負債—流動(附註六(二))	2,392	-	563	-
1150 應收票據淨額(附註六(三))	588	-	751	-	2150 應付票據	-	-	1,607	-
1170 應收帳款淨額(附註六(三))	3,015,880	17	2,950,815	19	2170 應付帳款	1,648,557	9	1,673,549	10
1200 其他應收款	105,789	1	63,284	-	2200 其他應付款(附註六(十三))	1,065,266	6	883,040	6
1220 本期所得稅資產	409	-	929	-	2230 本期所得稅負債	415,066	2	412,838	3
130X 存貨(附註六(四))	3,500,033	19	2,444,825	15	2322 一年內到期長期借款(附註六(十二))	322,349	2	65,000	-
1410 預付款項	251,545	1	177,271	1	2280 租賃負債—流動(附註六(十四))	106,012	-	113,331	1
1476 其他金融資產—流動(附註六(二))	599,488	3	373,584	2	2399 其他流動負債	325,900	2	232,681	1
	<u>11,071,211</u>	<u>61</u>	<u>8,868,174</u>	<u>55</u>	2100 短期借款(附註六(十一))	<u>5,352,057</u>	<u>29</u>	<u>4,304,035</u>	<u>27</u>
非流動資產：						\$ 1,466,515	8	921,426	6
1517 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—非流動(附註六(二))	4,157	-	-	-	非流動負債：				
1600 不動產、廠房及設備(附註六(六))	4,483,033	25	4,501,135	28	2540 長期借款(附註六(十二))	1,084,391	6	1,484,310	10
1755 使用權資產(附註六(七))	229,239	1	280,665	2	2580 租賃負債—非流動(附註六(十四))	123,214	1	190,820	1
1822 無形資產(附註六(八))	308,413	2	388,016	3	2640 淨確定福利負債—非流動(附註六(十五))	35,000	-	42,788	-
1805 商譽(附註六(九))	1,136,565	6	1,024,426	6	2570 遞延所得稅負債(附註六(十六))	825,106	5	684,722	4
1840 遞延所得稅資產(附註六(十六))	458,165	3	456,197	3	2670 其他非流動負債	71,568	-	51,787	-
1980 其他金融資產—非流動(附註六(二))	83,020	-	71,583	-		<u>2,139,279</u>	<u>12</u>	<u>2,454,427</u>	<u>15</u>
	<u>443,016</u>	<u>2</u>	<u>395,775</u>	<u>3</u>	負債總計	<u>7,491,336</u>	<u>41</u>	<u>6,758,462</u>	<u>42</u>
資產總計	\$ 18,216,819	100	15,985,971	100	歸屬母公司業主之權益：(附註六(十七))				
					3110 普通股股本	2,634,854	14	2,650,854	17
					3200 資本公積	2,137,088	12	2,166,799	14
					3300 保留盈餘	4,155,591	23	3,247,117	20
					3400 其他權益	(359,558)	(2)	(531,125)	(4)
					3500 庫藏股票	(506,043)	(3)	(506,990)	(3)
					歸屬母公司業主之權益合計	<u>8,061,932</u>	<u>44</u>	<u>7,026,655</u>	<u>44</u>
					36XX 非控制權益(附註六(五))	2,663,551	15	2,200,854	14
					權益總計	<u>10,725,483</u>	<u>59</u>	<u>9,227,509</u>	<u>58</u>
					負債及權益總計	\$ 18,216,819	100	15,985,971	100

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：王秀亭



經理人：王秀亭



會計主管：鄭懿誠



台灣半導體股份有限公司及其子公司

合併綜合損益表

民國一十一年及一十〇年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	111年度		110年度	
	金額	%	金額	%
4110 銷貨收入(附註六(十九))	\$ 16,442,867	105	13,612,887	103
4190 減:銷貨退回及折讓	755,733	5	435,470	3
營業收入淨額	15,687,134	100	13,177,417	100
5000 營業成本(附註六(四))	10,337,968	66	9,049,696	69
營業毛利	5,349,166	34	4,127,721	31
6000 營業費用(附註六(十五)及(二十一)):				
6100 推銷費用	1,296,411	8	1,175,935	9
6200 管理費用	906,846	6	726,018	5
6300 研究發展費用	355,388	2	316,861	2
營業淨利	2,558,645	16	2,218,814	16
營業外收入及支出(附註六(二十)):	2,790,521	18	1,908,907	15
7100 利息收入	19,892	-	14,541	-
7010 其他收入	46,025	-	46,312	-
7020 其他利益及損失	197,944	1	10,864	-
7050 財務成本	(40,452)	-	(32,992)	-
稅前淨利	223,409	1	38,725	-
7950 減:所得稅費用(附註六(十六))	3,013,930	19	1,947,632	15
本期淨利	837,015	5	565,737	4
8300 其他綜合損益:	2,176,915	14	1,381,895	11
8310 不重分類至損益之項目				
8311 確定福利計畫之再衡量數	7,368	-	(1,771)	-
8349 減:與不重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-
不重分類至損益之項目合計	7,368	-	(1,771)	-
8360 後續可能重分類至損益之項目				
8361 國外營運機構財務報表換算之兌換差額	341,796	2	(125,433)	(1)
8399 與可能重分類之項目相關之所得稅	(48,006)	-	15,123	-
後續可能重分類至損益之項目合計	293,790	2	(110,310)	(1)
8300 本期其他綜合損益(稅後淨額)	301,158	2	(112,081)	(1)
本期綜合損益總額	\$ 2,478,073	16	1,269,814	10
本期淨利歸屬於:				
母公司業主	\$ 1,562,887	10	882,805	7
非控制權益(附註六(五))	614,028	4	499,090	4
綜合損益總額歸屬於:	\$ 2,176,915	14	1,381,895	11
母公司業主	\$ 1,738,755	11	809,542	6
非控制權益(附註六(五))	739,318	5	460,272	4
基本每股盈餘(元)(附註六(二十二))	\$ 6.28		3.55	
稀釋每股盈餘(元)(附註六(二十二))	\$ 6.23		3.52	

董事長:王秀亭



(請詳閱後附合併財務報告附註)

經理人:王秀亭



會計主管:鄭懿誠



台灣半導體股份有限公司及子公司

合併權益變動表

民國一一年及一〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

歸屬於母公司業主之權益

	股本			保留盈餘			合計	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	庫藏股票	歸屬於母公司業主權益總計	非控制權益	權益總額
	普通股股本	預收股本	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘						
民國一〇年一月一日餘額	\$ 2,494,539	22,196	1,516,265	830,920	445,618	1,484,440	2,760,978	(459,300)	(506,990)	5,827,688	2,020,901	7,848,589
本期淨利	-	-	-	-	-	882,805	882,805	-	-	882,805	499,090	1,381,895
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	(1,438)	(1,438)	(71,825)	-	(73,263)	(38,818)	(112,081)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	-	881,367	881,367	(71,825)	-	809,542	460,272	1,269,814
可轉換公司債轉換	156,315	(22,196)	604,864	-	-	-	-	-	-	738,983	-	738,983
盈餘指撥及分配：												
提列法定盈餘公積	-	-	-	53,967	-	(53,967)	-	-	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	-	13,682	(13,682)	-	-	-	-	-	-
現金股利	-	-	-	-	-	(395,228)	(395,228)	-	-	(395,228)	-	(395,228)
發放予子公司股利調整資本公積	-	-	20,400	-	-	-	-	-	-	20,400	-	20,400
採用權益法認列之關聯企業變動數	-	-	25,270	-	-	-	-	-	-	25,270	-	25,270
非控制權益增減	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(280,319)	(280,319)
民國一〇年十二月三十一日餘額	2,650,854	-	2,166,799	884,887	459,300	1,902,930	3,247,117	(531,125)	(506,990)	7,026,655	2,200,854	9,227,509
本期淨利	-	-	-	-	-	1,562,887	1,562,887	-	-	1,562,887	614,028	2,176,915
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	4,301	4,301	171,567	-	175,868	125,290	301,158
本期綜合損益總額	-	-	-	-	-	1,567,188	1,567,188	171,567	-	1,738,755	739,318	2,478,073
庫藏股註銷	(16,000)	-	(69,482)	-	-	-	-	-	85,482	-	-	-
子公司購入母公司之股票視為庫藏股票	-	-	-	-	-	-	-	-	(84,535)	(84,535)	-	(84,535)
盈餘指撥及分配：												
提列法定盈餘公積	-	-	-	88,137	-	(88,137)	-	-	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	-	71,825	(71,825)	-	-	-	-	-	-
現金股利	-	-	-	-	-	(658,714)	(658,714)	-	-	(658,714)	-	(658,714)
發放予子公司股利調整資本公積	-	-	37,000	-	-	-	-	-	-	37,000	-	37,000
採用權益法認列之關聯企業變動數	-	-	2,771	-	-	-	-	-	-	2,771	-	2,771
非控制權益增減	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(276,621)	(276,621)
民國一一年十二月三十一日餘額	\$ 2,634,854	-	2,137,088	973,024	531,125	2,651,442	4,155,591	(359,558)	(506,043)	8,061,932	2,663,551	10,725,483

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：王秀亭



經理人：王秀亭



會計主管：鄭懿誠



台灣半導體股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國一一年及一〇年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	111年度	110年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 3,013,930	1,947,632
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	790,180	732,723
攤銷費用	140,791	123,565
預期信用減損損失	1,380	9,563
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)	51,151	(8,726)
利息費用	38,330	30,911
利息收入	(19,892)	(14,541)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失	4,840	3,601
非金融資產減損損失(迴轉利益)	(595)	2,701
其他	2,771	25,270
收益費損項目合計	<u>1,008,956</u>	<u>905,067</u>
與營業活動相關之資產/負債變動數：		
透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少	103,947	(143,918)
應收票據(增加)減少	163	(565)
應收帳款增加	(66,445)	(591,627)
其他應收款增加	(42,049)	(15,396)
存貨增加	(1,055,208)	(644,378)
預付款項增加	(92,899)	(7,114)
其他金融資產(增加)減少	(225,904)	108,236
應付票據減少	(1,607)	(45)
應付帳款增加(減少)	(24,992)	502,115
其他應付款增加	181,589	248,737
其他流動負債增加	92,684	93,849
淨確定福利負債減少	(7,788)	(2,459)
其他非流動負債增加	17,577	5,253
調整項目合計	<u>(111,976)</u>	<u>457,755</u>
營運產生之現金流入	2,901,954	2,405,387
收取之利息	19,436	14,559
支付之利息	(28,454)	(18,424)
支付之所得稅	(695,851)	(409,095)
營業活動之淨現金流入	<u>2,197,085</u>	<u>1,992,427</u>
投資活動之現金流量：		
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(4,157)	-
取得不動產、廠房及設備	(526,957)	(525,777)
處分不動產、廠房及設備	5,531	2,421
其他金融資產增加	(11,437)	(3,979)
取得無形資產	(35,317)	(26,639)
其他非流動資產增加	(27,074)	(45,846)
預付設備款增加	(92,105)	(156,963)
投資活動之淨現金流出	<u>(691,516)</u>	<u>(756,783)</u>
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加(減少)	545,089	(480,528)
償還可轉換公司債	-	(41,900)
舉借長期借款	419,320	679,760
償還長期借款	(561,890)	(430,000)
存入保證金減少	(130)	(35)
租賃本金償還	(127,258)	(86,168)
發放現金股利	(621,714)	(374,828)
庫藏股票買回成本	(84,535)	-
非控制權益淨變動	(276,621)	(280,319)
籌資活動之淨現金流出	<u>(707,739)</u>	<u>(1,014,018)</u>
匯率變動對現金及約當現金之影響	96,203	(83,648)
本期現金及約當現金增加數	894,033	137,978
期初現金及約當現金餘額	2,701,648	2,563,670
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 3,595,681</u>	<u>2,701,648</u>

董事長：王秀亭



(請詳閱後附合併財務報告附註)

經理人：王秀亭



會計主管：鄭懿誠



(附件二)

台灣半導體股份有限公司
審計委員會審查報告書



董事會造具民國 111 年度營業報告書、個體財務報告、合併財務報告及盈餘分配議案，其中個體財務報告及合併財務報告業經董事會委任安侯建業聯合會計師事務所梅元貞會計師及許育峰會計師查核竣事，並出具查核報告。上述營業報告書、個體財務報告、合併財務報告及盈餘分配議案經本審計委員會查核，認為尚無不符，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條之規定繕具報告。

敬請 鑒核

此 致

台灣半導體股份有限公司 112 年股東常會

台灣半導體股份有限公司

審計委員會召集人：詹乾隆



審 計 委 員：林柏生



審 計 委 員：范宏書



審 計 委 員：馬述壯



中 華 民 國 一 一 二 年 三 月 十 五 日

(附件四)

台灣半導體股份有限公司

111 年度
盈餘分配表



單位：新台幣元

項 目	金額小計	金額合計
期初未分配盈餘	1,084,254,443	
加：111 年度稅後純益	1,562,886,413	
加：確定福利計劃之再衡量數	4,300,684	
減：提列 10%法定盈餘公積	156,718,710	
本期可供分配盈餘		<u>2,494,722,830</u>
減：分配項目		
(1)股東股利 (每股 NT\$ 4.0 元)		
(現金股利每股 4.0 元)----(註)	<u>1,053,941,944</u>	<u>1,053,941,944</u>
期末未分配盈餘		<u>1,440,780,886</u>

註：

- 1) 嗣後如因本公司流通在外股數有增減變動，致股東配股(息)率因此發生變動者，擬提請股東會授權董事會全權處理之。
- 2) 本期股東股利共計發放金額為 NT\$ 1,053,941,944 元。
- 3) 111 年度稅後純益經分配後剩餘 NT\$ 356,526,443 元未分配。

董事長：王秀亭



經理人：王秀亭



會計主管：鄭懿誠

